

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年6月16日(2005.6.16)

【公開番号】特開2002-299315(P2002-299315A)

【公開日】平成14年10月11日(2002.10.11)

【出願番号】特願2001-95306(P2001-95306)

【国際特許分類第7版】

H 01 L 21/3065

H 01 L 21/205

H 01 L 21/304

【F I】

H 01 L 21/302 A

H 01 L 21/205

H 01 L 21/304 6 4 5 C

【手続補正書】

【提出日】平成16年9月17日(2004.9.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

半導体基板を含む複数の被処理基体群を半導体製造装置を用いて一群ずつ処理する方法であって、前記方法は、

順次処理される少なくとも第1及び第2の被処理基体群を含む前記複数の被処理基体群を用意し、

前記第1及び第2の被処理基体群の処理タイプに基づいて、前記第2の被処理基体群を処理する前に前記半導体製造装置に対して所定の措置を施す必要があるか否かを判断し、

所定の措置を施す必要がない場合、前記所定の措置を施さずに前記第2の被処理基体群を処理することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項2】

半導体基板を含む複数の被処理基体群を半導体製造装置を用いて一群ずつ処理する方法であって、前記方法は、

複数の被処理基体群を用意し、

最初の被処理基体群の後に処理する、残りの被処理基体群のうち、前記最初の被処理基体群の処理が終了した後に、前記半導体製造装置に対して所定の措置を施さずに処理を行える少なくとも1つの被処理基体群を抽出し、この抽出した被処理基体群を前記最初の被処理基体群の後に処理することを特徴とする半導体装置の製造方法。